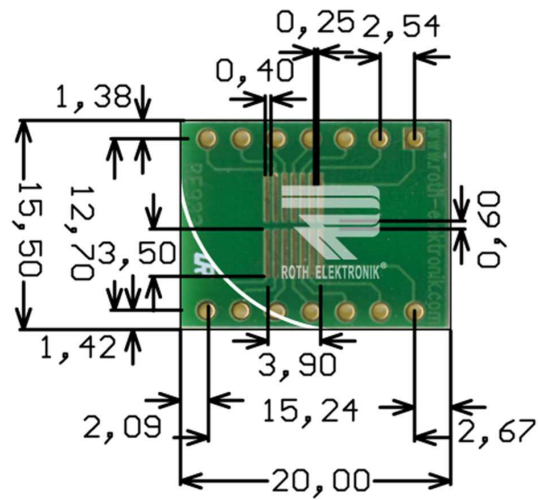
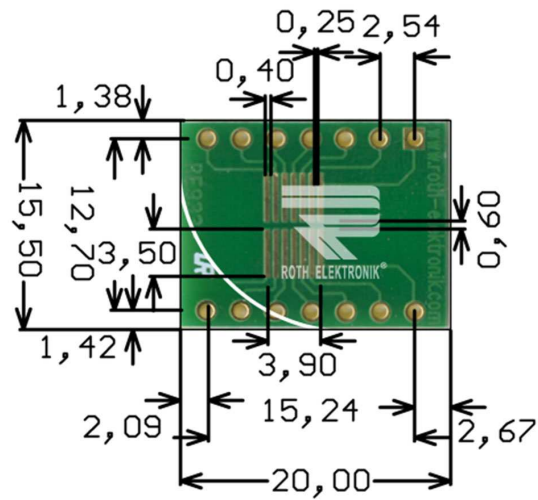




RE933-02ST

- Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm
- Double-sided 35 µm Cu
- Plated through holes (PTH)
- Surface chem. Ni/Au with solder stop mask
- Adaption circuit board for TSSOP 14 designed in a single row
- Pitch: 0.65 mm (173 mil)
- Hole diameter 1.00 mm
- Size 15.50 x 20.00 mm

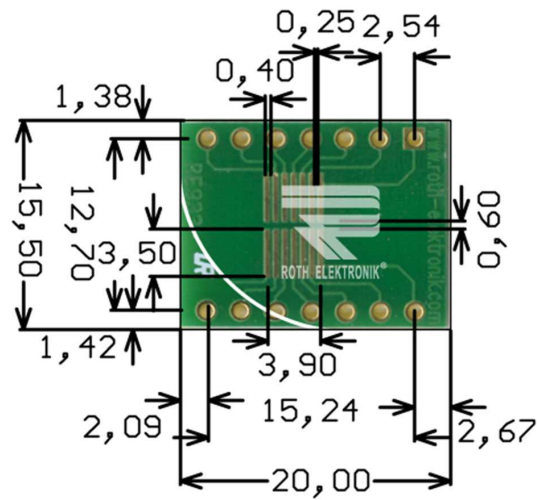
ver.20150130



RE933-02ST

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaption Platine für TSSOP 14 einreihig ausgeführt
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 15,50 x 20,00 mm

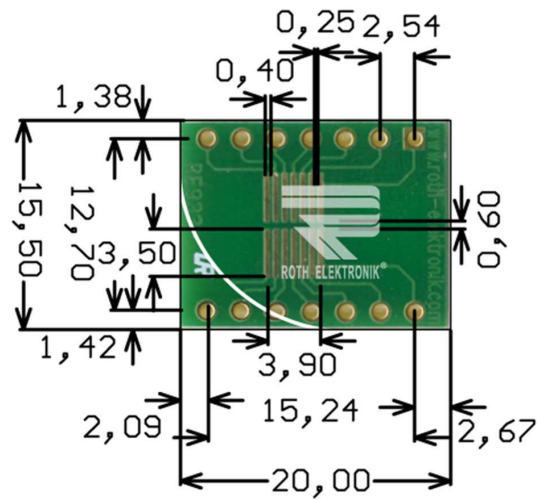
ver.20150130



RE933-02ST

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour TSSOP 14 conçue sur une rangée
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Dimensions 15,50 x 20,00 mm

ver.20150130



RE933-02ST

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para TSSOP 14 introducida en una línea
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Tamaño 15,50 x 20,00 mm

ver.20150130